

Sicherheitshinweise

Metallstaub ist gesundheitsschädlich. Beim Ausarbeiten Absaugung benutzen. Allergien gegen Bestandteile der Legierung oder elektrochemisch bedingte Missempfindungen sind in seltenen Einzelfällen möglich.

Wechselwirkungen

Bei okklusalem und approximalem Kontakt unterschiedlicher Legierungen sind in seltenen Einzelfällen elektrochemisch bedingte Missemfindungen möglich.

Gewährleistung

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, ganz gleich ob sie mündlich, schriftlich oder im Wege praktischer Anleitung erteilt werden, beruhen auf unseren eigenen Erfahrungen und Versuchen und können daher nur als Richtwerte gesehen werden. Die Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns deshalb Änderungen in Konstruktion und Zusammensetzung vor. Bitte trocken und bei Raumtemperatur lagern.

Korrosionsfestigkeit und Biokompatibilität sind geprüft. Ergebnisse können kostenfrei angefordert werden. D 7.2015. © C.HAFNER, D-Wimsheim.

C.HAFNER Service: Bestell-Telefon: +49 7044 90333-333

ORPLID® TK

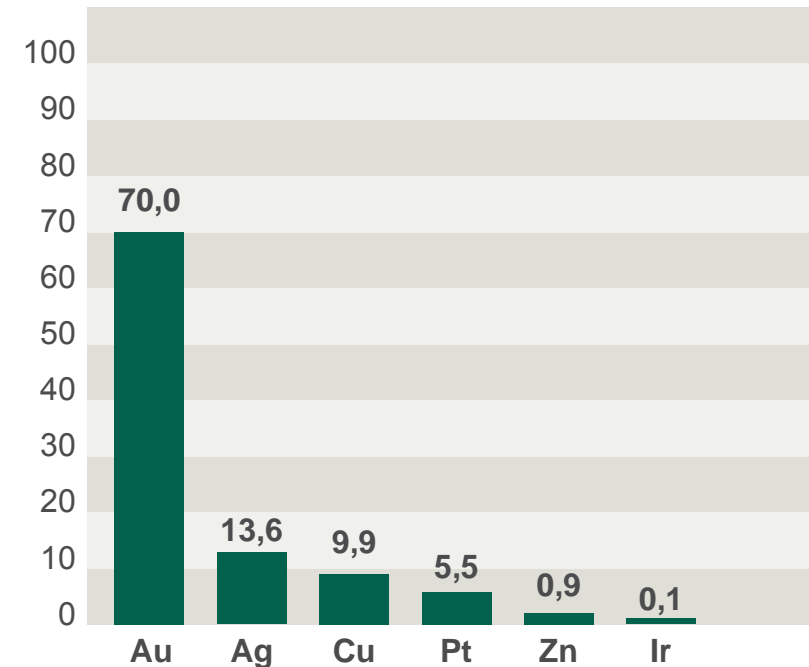
LOT _____

Farbe: Gelb

Gramm: _____

Typ: 4

Legierungszusammensetzung %



Ag Silber, **Au** Gold, **Cu** Kupfer, **Fe** Eisen, **Ga** Gallium, **Ge** Germanium, **In** Indium, **Ir** Iridium, **Mn** Mangan, **Pd** Palladium, **Pt** Platin, **Re** Rhenium, **Rh** Rhodium, **Ru** Ruthenium, **Sn** Zinn, **Ta** Tantal, **Zn** Zink



Technische Daten ORPLID® TK

Hochgoldhaltige Gusslegierung nach DIN EN ISO 22674

Dichte (g/cm ³)	15,4
Schmelzintervall °C	895-925
Härte (HV 5/30) w,a,g/b	190, 255, 250
Vorwärmtemperatur °C	700
Gießtemperatur °C	1055
Weitererhitzen nach dem Aufschmelzen (s)	
elektrisch 15-20, induktiv 5-8, Flamme 5-8	
0,2% Dehngrenze (MPa) w, a, g/b	375, 620, 645
Bruchdehnung (%) w, a, g/b	35, 15, 10
Flußmittel:	z.B. Pasta Flux
WAK 25-500 (600) °C	- µm/mK
Lotempfehlung:	ORPLID® Lote 825, 790, 760

w = weich, a = ausgehärtet, g/b = nach dem Guß bzw. Brand

Verarbeitungsanleitung

Anstiften:

nach zahntechnischen Regeln (siehe Allgemeine Gebrauchsanweisung)

Einbetten:

phosphatgebundene Einbettmassen (z.B. Ceha-cast Speed)

Vorwärmen:

700°C, 30-120 min. auf Endtemperatur, je nach Muffelgröße

Gießen:

1055°C, bei Vakuum-Druckguss widerstandsbeheizt um 20-30°C erhöhen. Graphittiegel bzw. bei offener Flamme mit Keramiktiegel

Ausarbeiten:

mit Hartmetallfräsen und/oder keramisch gebundenen Steinen.

Reinigen:

Ultraschallreinigung oder abdampfen mit Dampfstrahlgerät.